

证券代码：688820

证券简称：盛合晶微

公告编号：2026-001

盛合晶微半导体有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意盛合晶微半导体有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕373号），盛合晶微半导体有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）255,466,162股（以下简称“本次发行”）。容诚会计师事务所于2026年4月15日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字〔2026〕230Z0052号）。公司已完成本次发行并于2026年4月21日在上海证券交易所科创板上市。

根据上述首次公开发行的情况，公司于2026年4月29日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对公司上市后适用的《盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation）经第九次修订及重述的公司章程大纲细则》（草案）》（含中文及英文版本）（以下简称“《公司章程（草案）》”）中有关条款进行修订，并将其名称变更为《盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation）经第九次修订及重述的公司章程大纲细则》（以下简称“《公司章程》”），具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第二条	公司于【核准日期】经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）（【文号】）批准注册，首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股，于【上市日期】	公司于2026年3月3日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）（（2026）373号）文件批准注册，首次向社会公众发行人民币普通股255,466,162股，

	在上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市。	于 2026 年 4 月 21 日 在上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市。
--	------------------------	---

除上述条款修订外，原《公司章程（草案）》中的其他条款保持不变。

公司首次公开发行股票并在科创板上市相关事宜已获股东会授权董事会全权办理，本次变更无需提交公司股东会审议。

修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

盛合晶微半导体有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日